

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成28年7月21日(2016.7.21)

【公開番号】特開2014-4681(P2014-4681A)

【公開日】平成26年1月16日(2014.1.16)

【年通号数】公開・登録公報2014-002

【出願番号】特願2013-129309(P2013-129309)

【国際特許分類】

B 8 1 B 7/02 (2006.01)

H 01 L 29/84 (2006.01)

G 01 P 15/08 (2006.01)

【F I】

B 8 1 B 7/02

H 01 L 29/84 Z

H 01 L 29/84 A

G 01 P 15/08 P

【手続補正書】

【提出日】平成28年6月2日(2016.6.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

センサ、および

接合部分

を備えるMEMSダイと、

アイソレーション装置と

を備える微小電子機械システム(MEMS)パッケージであって、前記アイソレーション装置が、

前記MEMSダイの前記接合部分に接合されるように構成され、前記MEMSダイの前記接合部分の熱膨張率にほぼ等しい熱膨張率を有する第1の層と、

モノリシック材料で形成されたばね層と

を備え、前記ばね層が、

前記第1の層に接合するように構成された第1の区間と、

回路板に接合するように構成された第2の区間と、

前記第1の区間を前記第2の区間に柔軟に取り付けられるように構成された1つまたは複数のばね要素と

を備える、MEMSパッケージ。

【請求項2】

前記第1の層が、前記MEMSダイが前記第1の層に実装されたときMEMSダイが通過することを可能にするように構成された空洞を備え、前記空洞が、前記MEMSダイだけに接合されるように構成された少なくとも1つのフランジを備え、前記第1の層または前記ばね層のうちの少なくとも1つが、前記少なくとも1つのフランジを前記ばね層から分離するように構成された凹部を備える、請求項1に記載のパッケージ。

【請求項3】

前記ばね層がシリコンを含み、前記第1の層がガラスを含む、請求項1に記載のパッケ

— ジ。